

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



**Europäisches  
Patentamt**

**European  
Patent Office**

**Office européen  
des brevets**

22278 U.S. PTO  
10/757966



**Bescheinigung**

**Certificate**

**Attestation**

Die angehefteten Unterla-  
gen stimmen mit der  
ursprünglich eingereichten  
Fassung der auf dem näch-  
sten Blatt bezeichneten  
europäischen Patentanmel-  
dung überein.

The attached documents  
are exact copies of the  
European patent application  
described on the following  
page, as originally filed.

Les documents fixés à  
cette attestation sont  
conformes à la version  
initialement déposée de  
la demande de brevet  
européen spécifiée à la  
page suivante.

**Patentanmeldung Nr. Patent application No. Demande de brevet n°**

03001015.1

Der Präsident des Europäischen Patentamts;  
Im Auftrag

For the President of the European Patent Office

Le Président de l'Office européen des brevets  
p.o.

**R C van Dijk**

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

S/N Unknown

PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant: Volker Haag et al.

Examiner: Unknown

Serial No.: Unknown

Group Art Unit: Unknown

Filed: Herewith

Docket: 1689.006US1

Title: TOP OR BOTTOM PART FOR A MODULE CHASSIS

---

**COMMUNICATION REGARDING FILING OF  
PRIORITY DOCUMENT**

MS PATENT APPLICATION

Commissioner for Patents

P.O.Box 1450

Alexandria, VA 22313-1450

In accordance with the requirements for claiming right of priority under 35 U.S.C. 119, enclosed for filing in connection with the above-identified application is a certified copy of Applicant's prior application, European Application SN 03 001 015.1, filed January 17, 2003.

Respectfully submitted,

VOLKER HAAG ET AL.

By their Representatives,

SCHWEGMAN, LUNDBERG, WOESSNER & KLUTH, P.A.  
P.O. Box 2938  
Minneapolis, MN 55402  
(612) 359-3267

Date 1/15/04 By *Peter C Maki*  
Peter C Maki  
Reg. No. 42,832

"Express Mail" mailing label number: EV 299 686 857 US

Date of Deposit: January 15, 2004

This paper or fee is being deposited on the date indicated above with the United States Postal Service pursuant to 37 CFR 1.10, and is addressed to the Commissioner for Patents, Mail Stop Patent Application, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

**THIS PAGE BLANK**

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



Anmeldung Nr:  
Application no.: 03001015.1  
Demande no:

Anmeldetag:  
Date of filing: 17.01.03  
Date de dépôt:

Anmelder/Applicant(s)/Demandeur(s):

Schroff GmbH  
Industriegebiet  
D-75334 Straubenhardt  
ALLEMAGNE

Bezeichnung der Erfindung/Title of the invention/Titre de l'invention:  
(Falls die Bezeichnung der Erfindung nicht angegeben ist, siehe Beschreibung.  
If no title is shown please refer to the description.  
Si aucun titre n'est indiqué se referer à la description.)

Kopf- oder Bodenteil für einen Baugruppenträger

In Anspruch genommene Priorität(en) / Priority(ies) claimed /Priorité(s)  
revendiquée(s)  
Staat/Tag/Aktenzeichen/State/Date/File no./Pays/Date/Numéro de dépôt:

Internationale Patentklassifikation/International Patent Classification/  
Classification internationale des brevets:

H05K7/00

Am Anmeldetag benannte Vertragstaaten/Contracting states designated at date of  
filing/Etats contractants désignées lors du dépôt:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LU MC NL  
PT SE SI SK TR LI

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



**DURM & DURM**

PATENTANWÄLTE

MOLTKESTRASSE 45 76133 KARLSRUHE

S 5703/03-EU

17. Januar 2003

Schroff GmbH

**Kopf- oder Bodenteil für einen Baugruppenträger****Beschreibung**

Die Erfindung betrifft ein Kopf- oder Bodenteil für einen Baugruppenträger, mit einem umlaufenden Rahmen und mit zwischen der vorderen und hinteren Rahmenleiste angeordneten und in Einschubrichtung ausgerichteten Führungsschienen zur Aufnahme einer Leiterplatte einer Steckbaugruppe, wobei die Führungsschienen im Querschnitt U-förmig ausgebildet sind und einen Boden und zwei Seitenwände umfassen.

Elektronische und elektrische Geräte der Industrielektronik sind in Form von modularen Baugruppenträgern aufgebaut. Die Baugruppenträger dienen zur Aufnahme von einsteckbaren elektronischen Steckbaugruppen, die in dafür vorgesehene Steckplätze eingeschoben werden. In ihrer einfachsten Form bestehen die Baugruppenträger aus zwei Seitenwänden und vier parallelen Modulschienen, welche mit ihren Stirnflächen an die beiden Seitenwände angrenzen. Ein Deckblech und ein Bodenblech sowie eine Rückwand können den Baugruppenträger zu einem Gehäuse ergänzen. Von der offenen Frontseite her werden die Steckbaugruppen auf Führungsschienen eingeschoben, die zumeist einzeln an

...

- 2 -

der vorderen und hinteren Modulschiene befestigt sind. Die Modulschienen können auch integrierte Bestandteile des Deckblechs bzw. des Bodenblechs sein, wie beispielsweise in DE 198 17 089 C1 beschrieben.

Auf die Modulschienen aufgesteckte Führungsschienen sind in der Regel aus Kunststoff hergestellt und derart an den Modulschienen befestigt, dass die Teilfrontplatten der eingesteckten Steckbaugruppen aneinandergrenzen. Durch eine variable Anordnung der Führungsschienen können Steckbaugruppen mit unterschiedlich breiten Teilfrontplatten miteinander kombiniert werden. Auch ist eine nachträgliche Verlegung der Führungsschienen mit geringem Aufwand möglich.

In vielen elektronischen Systemen ist diese Variabilität jedoch nicht gefordert, so dass auf den relativ teuren, aus vielen Einzelteilen bestehenden Aufbau eines Baugruppenträgers verzichtet werden kann. Gerade das manuelle, nachträgliche Einsetzen der Führungsschienen erhöht die Herstellungskosten solcher Baugruppenträger erheblich. Aus Kostengründen werden deshalb in zunehmendem Maße die Boden- und Kopfgruppen der Baugruppenträger nicht mehr aus einer Vielzahl von Einzelteilen hergestellt. Statt dessen wird das ganze Boden- bzw. Kopfteil des Baugruppenträgers aus einem einzigen Bauteil gefertigt, das die Modulschienen, das Boden- bzw. Deckblech und die Führungsschienen umfasst.

Ein solches integriertes Boden- bzw. Kopfteil besteht im Prinzip aus einem rechteckigen Metallblech, dessen Ränder einfach oder mehrfach abgekantet sind. Die Abkantungen dienen zum einen zur Versteifung; zum anderen bieten sie eine Anlagefläche für die Seitenteile des Baugruppenträgers und stellen Befestigungspunkte für die angrenzenden Teile dar. Aus der Fläche des Metallblechs werden die Führungsschienen herausgearbeitet. Dazu werden in das Blech Schlitzte derart eingearbeitet, dass ein umlaufender Rahmen und zwischen der vorderen und hinteren Rahmenleiste parallel verlaufende Stege entstehen. Die Breite jedes Steges entspricht der Breite des Bodens einer Führungsschiene plus der Höhe der beiden Seitenwände der Führungsschiene. Die Seitenwände der Führungsschiene werden aus den Stegen um 90 Grad herausgebogen, so dass eine U-förmige Führungsschiene entsteht. Zwei benachbarte Führungsschienen sind wenigstens im Abstand der doppelten Höhe der Seitenwände der Führungsschiene angeordnet. Bei einem größeren Abstand zwischen zwei benachbarten Führungsschienen können die verbleibenden Flächen entfernt werden, wenn beispielsweise eine

...

- 3 -

verbesserte Belüftung des Baugruppenträgers gefordert ist. Dies kann insbesondere beim Einsatz von modernen Steckbaugruppen mit hohen Taktfrequenzen oder mit großer Leistungsaufnahme erforderlich sein.

Moderne Steckbaugruppen in elektrischen und elektronischen Systemen enthalten hochintegrierte Halbleiterbauelemente und sind somit besonders gegen elektrostatische Entladungen gefährdet. Durch die niedrigen Schaltpegel in den elektronischen Schaltungen bei gleichzeitig sehr hohen Taktfrequenzen und entsprechend kurzen Einstiegszeiten der Logikbauteile können schon relativ kleine Ladungen zu Störungen auf der Leiterplatte oder sogar zum Zerstören von einzelnen Komponenten führen. Gerade unter ungünstigen klimatischen Bedingungen können sich schnell hohe Ladungen auf den Steckbaugruppen ansammeln. Beim Einschieben der Steckbaugruppen in den Baugruppenträger, spätestens jedoch, wenn die Steckbaugruppe mit der Rückverdrahtungsplatine des Baugruppenträgers kontaktiert wird, gleichen sich dann die Potentiale zwischen der aufgeladenen Steckbaugruppe und dem auf Massepotential liegenden Baugruppenträger schlagartig aus. Dadurch können kurzzeitige extrem hohe Entladungsströme auftreten, die zu Beschädigungen oder Zerstörungen führen.

Um ein unkontrolliertes Entladen der Steckbaugruppe beim Einschieben in den Baugruppenträger zu vermeiden, wird üblicherweise am unteren Rand der Leiterplatte ein streifenförmiger metallischer Bereich vorgesehen. Dieser Kontaktstreifen am unteren Rand ist in mehrere Abschnitte, sogenannte Segmente, untergliedert. Diese Segmente sind mit unterschiedlichen Bereichen der Leiterplatte galvanisch verbunden. Beispielsweise ist ein Segment mit dem Logikteil der Steckbaugruppe verbunden, ein weiteres mit den Masseflächen. In der Regel ist auch die Frontplatte der Steckbaugruppe galvanisch mit einem speziellen Segment am unteren Rand der Leiterplatte kontaktiert.

In den Führungsschienen der Baugruppenträger ist üblicherweise ein Kontaktelement integriert. Das Kontaktelement ist in der Regel als Kontaktfeder ausgebildet und befindet sich am vorderen Ende der Führungsschiene. Das Kontaktelement ist mit dem Baugruppenträger leitend verbunden.

Beim Einschieben der Steckbaugruppe in den Baugruppenträger schleifen nun die einzelnen Segmente im unteren Rand der Leiterplatten an dem Kontaktele-

...

- 4 -

ment der Führungsschiene vorbei, so dass die mit den Segmenten verbundenen Bereiche auf der Leiterplatte nacheinander und unabhängig voneinander kontrolliert entladen werden. Hierzu können auf der Leiterplatte Widerstände im Entladepfad angeordnet sein, die dazu dienen, den Entladestrom auf ein zulässiges und für die Steckbaugruppe verträgliches Maß zu begrenzen.

Bei Baugruppenträgern, bei denen das ganze Boden- bzw. Kopfteil aus einem Stück Blech gefertigt ist, sind die Führungsschienen ebenso aus Metall ausgebildet wie die Seitenwände des Baugruppenträgers. Wird in diese durchgängig metallischen Führungsschienen eine Steckbaugruppe eingeschoben, so kommt es zu Problemen: Die einzelnen Segmente am unteren Rand der Leiterplatte werden durch die metallisch leitende Seitenwände der Führungsschienen untereinander verbunden und somit kurzgeschlossen. Damit werden auch die einzelnen Logikteile und Masseflächen auf der Leiterplatte galvanisch miteinander verbunden. Dies kann in ungünstigen Fällen nicht nur zu Störungen, sondern durchaus auch zu einer Zerstörung der Steckbaugruppe oder einzelner elektronischer Komponenten führen.

Um solche Kurzschlüsse zu vermeiden, werden die Seitenwände der Führungsschienen in den Bereichen entfernt, die mit den leitfähigen Segmenten am Rand der Leiterplatte korrespondieren. Dadurch wird vermieden, dass die Logikteile und die spannungsführenden Teile der Leiterplatte mit der Gehäusemasse geerdet werden. Unter Umständen müssen die Ausnehmungen in den Seitenwänden der Führungsschienen recht groß sein. Nachteilig ist dabei, dass die Ausnehmungen der Seitenwände die Steifigkeit der Führungsschienen drastisch verringern. Unachtsam eingeschobene Steckbaugruppen bewirken ein Verbiegen oder führen zu Beschädigungen an den einzelnen Führungsschienen. In Einzelfällen können die Führungsschienen sogar brechen.

Nachteilig erweist sich weiterhin, dass sich die Steckbaugruppen beim Einschieben in den Baugruppenträger leicht an den Ausnehmungen der Seitenwände der Führungsschienen verhaken können. Ein glattes und reibungsloses Hineinschieben der Steckbaugruppen in den Baugruppenträger ist dann nicht mehr gewährleistet. Vielmehr muss die Steckbaugruppe durch Hin- und Herbewegen vorsichtig in die Führungsschiene eingeschoben werden. Das Verhaken an den Schnittkanten der Unterbrechungen der Seitenwände kann auch Beschädigungen auf

...

- 5 -

der Leiterplatte bzw. der Steckbaugruppe selbst hervorrufen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es deshalb, ein aus Metallblech kostengünstig herstellbares Kopf- bzw. Bodenteil für einen Baugruppenträger mit integrierten Führungsschienen vorzuschlagen, das einerseits ausreichende mechanische Stabilität aufweist, andererseits aber sicher vermeidet, dass bei vollständig eingeschobener Leiterplatte bestimmte Abschnitte des unteren Rands der Leiterplatte mit der Führungsschiene in Kontakt kommen.

Zur Lösung der Aufgabe wird von einem Kopf- oder Bodenteil für einen Baugruppenträger mit einem umlaufenden Rahmen und mit zwei zwischen der vorderen und hinteren Rahmenleiste angeordneten und in Einschubrichtung ausgerichteten Führungsschienen zur Aufnahme einer Leiterplatte einer Steckbaugruppe ausgegangen, wobei die Führungsschienen im Querschnitt U-förmig ausgebildet sind und einen Boden und zwei Seitenwände umfassen.

Gelöst wird die Aufgabe zunächst dadurch, dass die Seitenwände der Führungsschienen mindestens eine seitliche Ausbuchtung aufweisen. Durch diese Ausbuchtung wird gewährleistet, dass die Führungsschiene Bereiche aufweist, die nicht mit dem unteren Rand der Leiterplatte der Steckbaugruppe in Kontakt kommen. Gleichzeitig werden die Seitenwände der Führungsschienen jedoch nicht unterbrochen, so dass die Steifigkeit und Stabilität der Führungsschiene voll erhalten bleibt.

In einer bevorzugten Ausführungsform sind die Ausbuchtungen an beiden Seitenwänden der Führungsschienen vorgesehen. So kann auf technische Besonderheiten der einzelnen Leiterplatten eingegangen werden. Vorteilhaft ist diese Ausführung besonders beim Einsatz von Steckbaugruppen mit Doublelayer- oder Multilayer-Leiterplatten.

Insbesondere können die Ausbuchtungen der beiden Seitenwände paarweise gegenüberliegen. Die Führungsschienen haben dann einen symmetrischen Aufbau.

Besonders vorteilhaft ist ein Kopf- oder Bodenteil, bei dem der Abstand zwischen den beiden Seitenwänden einer Führungsschiene der Dicke der Leiterplatte der Steckbaugruppe entspricht und die Ausbuchtungen in den Seitenwänden der

...

- 6 -

Führungsschiene nach außen gerichtet sind. Die Leiterplatte wird dann von den Seitenwänden der Führungsschiene gehalten. Die Ausbuchtungen stellen die abschnittsweisen Bereiche dar, in denen die Leiterplatte keinen Kontakt mit der Führungsschiene hat. Bei der Herstellung einer solchen Ausführungsform werden zunächst die Führungsschienen ausgebildet, wobei der Abstand zwischen den Seitenwänden der Dicke der Leiterplatte entspricht. Anschließend werden dann partiell aus den Seitenwänden die Ausbuchtungen nach außen gebogen.

Die Ausbuchtungen der Seitenwände sollten mit den Kontaktstreifen (Segmenten) am unteren Rand der Leiterplatte der Steckbaugruppe korrespondieren. So wird gewährleistet, dass die Kontaktstreifen bzw. die stromführenden Bereiche am unteren Rand der Leiterplatte keinen Kontakt mit den Führungsschienen haben, wenn die Baugruppe ganz eingeschoben ist. Auf diese Weise wird vermieden, dass spannungsführende bzw. leitende Teile der Leiterplatte über die Führungsschienen ungewollt mit dem Gehäuse des Baugruppenträgers oder gar untereinander verbunden werden. Die Ausbuchtungen der Seitenwände ersetzen die bekannten Ausnehmungen in den Seitenwänden der herkömmlichen Führungsschienen. Gegenüber diesen wird die erfindungsgemäße Führungsschiene aber nicht durch Ausnehmungen in den Seitenwänden geschwächt und deren Steifigkeit herabgesetzt.

Eine zweite Lösung der gestellten Aufgabe besteht darin, dass die Seitenwände der Führungsschienen mindestens eine seitliche Einbuchtung aufweisen. In diesem Fall liegen lediglich die Einbuchtungen seitlich an der Leiterplatte an. Auch hier ergeben sich abschnittsweise Bereiche, in denen die Seitenwände der Führungsschiene nicht mit der Leiterplatte der Steckbaugruppe in Berührung kommen.

Bevorzugt wird eine Ausführung, bei der beide Seitenwände der Führungsschiene mindestens eine Einbuchtung aufweist.

Weiterhin vorteilhaft ist es, wenn sich die Einbuchtungen paarweise gegenüberliegen. Dadurch ergibt sich auch hier ein symmetrischer Aufbau der Führungsschienen.

Bei einer besonders vorteilhaften Ausführungsform des Kopf- oder Bodenteils

...

- 7 -

entspricht der Abstand zwischen zwei gegenüberliegenden Einbuchtungen der Dicke der Leiterplatte der Steckbaugruppe. Auf diese Weise wird die Leiterplatte nur von den Einbuchtungen der Führungsschiene gehalten. Ansonsten berührt die Leiterplatte die Seitenwände nicht.

Korrespondieren die Einbuchtungen der Seitenwände mit isolierenden Bereichen und/oder Masseflächen am unteren Rand der Leiterplatte, so wird vermieden, dass die stromführenden Teile der Leiterplatte bei vollständig in den Baugruppenträger eingeschobener Steckbaugruppe mit der Führungsschiene in Berührung kommen. Bei eingeschobener Steckbaugruppe stehen die stromführenden Bereiche am unteren Bereich der Leiterplatte den Seitenwänden mit Abstand gegenüber. Während des Einschiebens in den Baugruppenträger werden hingegen die einzelnen Bereiche nacheinander mit den Einbuchtungen der Führungsschiene kontaktiert. So wird erreicht, dass die Leiterplatte vor der Verbindung mit der Rückverdrahtungsplatine frei von elektrostatischen Aufladungen ist.

Vorteilhaft erweist sich eine Ausführungsform, bei der im Bereich der Ausbuchtungen bzw. der Einbuchtungen die Seitenwände vom Boden der Führungsschiene getrennt sind. Es entsteht dadurch in den Bereichen der Ausbuchtungen bzw. Einbuchtungen eine schlitzzartige Öffnung am Boden der Führungsschiene. Auf diese Weise wird vermieden, dass bei der Verformung der Seitenwände auch der Boden der Führungsschiene verformt wird. Bei derart freigeschnittenen Seitenwänden im Bereich der Ausbuchtungen bzw. der Einbuchtungen bleibt der Boden der Führungsschiene auch nach der Verformung der Seitenwände plan. Die Steckbaugruppen können glatt in die Führungsschiene eingeführt werden.

Bevorzugt wird eine Ausführungsform eines Kopf- oder Bodenteils, bei dem die Einbuchtungen in den Seitenwänden der Führungsschiene federnd ausgebildet sind. Die federnd ausgeführten Einbuchtungen pressen sich an die Leiterplatte an. Dadurch wird die Leiterplatte zuverlässig in der Führungsschiene gehalten. Auch können auf diese Weise Toleranzen in der Dicke der Leiterplatte ausgeglichen werden.

Schräg oder abgerundet ausgebildete Übergänge zwischen den Seitenwänden und den Ausbuchtungen bzw. den Einbuchtungen der Führungsschiene weisen den Vorteil auf, dass Sprünge und scharfe Kanten vermieden werden. Auf diese

...

- 8 -

Weise unterbleibt ein Verhaken der Leiterplatte bzw. Steckbaugruppe beim Einschieben in den Baugruppenträger. Beschädigungen an der Leiterplatte durch ein Verhaken oder Entlangkratzen an den eventuell scharfkantigen Übergängen während des Einschiebens werden damit ausgeschlossen.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nachstehend anhand der beigefügten Abbildungen näher erläutert. Es zeigen:

- Figur 1        einen Baugruppenträger mit Kopfteil und Bodenteil, perspektivisch;
- Figur 2        das Bodenteil des Baugruppenträgers aus Figur 1;
- Figur 3        eine perspektivische Darstellung einer Führungsschiene mit Ausbuchtungen, als Teil des Bodenteils aus Figur 2;
- Figur 4        eine Draufsicht der Führungsschiene nach Figur 3;
- Figur 5        eine alternative Führungsschiene mit freigeschnittenen Ausbuchtungen, perspektivisch;
- Figur 6        einen Teil der Führungsschiene aus Figur 5, in Draufsicht;
- Figur 7        eine alternative Führungsschiene mit nach innen weisenden Einbuchtungen, perspektivisch;
- Figur 8        eine Draufsicht auf die Führungsschiene von Figur 8.

Der Baugruppenträger in Figur 1 umfasst zwei Seitenteile 1, ein Kopfteil 2 und ein Bodenteil 3. Das Kopfteil 2 und das Bodenteil 3 sind zwischen den beiden Seitenteilen 1 angeordnet, wobei das Kopfteil 2 im oberen Bereich der Seitenteile 1 und das Bodenteil 3 im unteren Bereich der Seitenteile 1 fixiert ist.

In Figur 2 ist das Bodenteil 3 im Detail zu sehen. Das Bodenteil 3 weist einen umlaufenden Rahmen 4 auf, dessen Außenbereiche nach unten hin abgekantet sind, so dass Randflächen 5 entstehen, die senkrecht zum Bodenteil 3 ausgerichtet



- 9 -

sind. Die Randflächen 5 stellen Befestigungsflächen für die Seitenteile 1 und gegebenenfalls für eine Rückwand oder eine Frontplatte dar.

Zwischen den vorderen und hinteren Rahmenleisten 6, 7 des Rahmens 4 sind Führungsschienen 8 herausgearbeitet. Die Führungsschienen 8 verlaufen in Einschubrichtung und bilden zusammen mit dem umlaufenden Rahmen 4 eine rostartige Struktur.

Am vorderen Ende weisen die Führungsschienen 8 eine trichterförmige Aufweitung 9 auf. Steckbaugruppen, die in die Führungsschienen 8 eingeschoben werden, werden durch die Aufweitung 9 in die Führungsschienen 8 hineingeführt. Im Bereich dieser trichterförmigen Aufweitung 9 können auch zusätzlich federnde Kontaktelemente (nicht dargestellt) angeordnet sein, die über einen Widerstand mit dem Gehäuse des Baugruppenträgers verbunden sind. Damit wird bei Einsatz von Steckbaugruppen mit Entladungsflächen im unteren Bereich der Leiterplatte ein kontrolliertes Entladen der Steckbaugruppen erzwungen.

Im vorderen Bereich weisen die Führungsschienen 8 je zwei sich paarweise gegenüberliegende, nach außen gerichtete Ausbuchtungen 10 auf.

Figur 3 zeigt die Ausbuchtungen 10 der Führungsschiene 8 im Detail. Die Führungsschiene 8 ist U-förmig aufgebaut. Sie umfasst einen Boden 11 und zwei Seitenwände 12. Die Ausbuchtungen 10 sind nach außen hin ausgeformt. Der Übergang von der normal verlaufenden Seitenwand 12 zur Ausbuchtung 10 ist mit großen Radien realisiert. Im mittleren Bereich der Ausbuchtung 10 verläuft die Ausbuchtung 10 ebenso parallel wie die Seitenwände 12.

Figur 4 zeigt die symmetrische Anordnung der paarweise gegenüberliegenden Ausbuchtungen 10 der Führungsschienen 8. Der Übergang zwischen der Seitenwand 12 und der Ausbuchtung 10 verläuft stetig. Um scharfe Kanten zu vermeiden, ist der Übergang mit großen Radien gestaltet.

Der Abstand  $b$  zwischen zwei Seitenwänden 12 entspricht der Dicke einer Leiterplatte einer Steckbaugruppe. Eine Steckbaugruppe wird folglich zwischen den Seitenwänden 12 geführt. Im Bereich der Ausbuchtung 10 hat die Leiterplatte hingegen keinen Kontakt mit der Führungsschiene 8.

...

- 10 -

Figur 5 zeigt eine spezielle Ausführung einer Führungsschiene 8. Im Bereich der Ausbuchtungen 10 ist die Seitenwand 12 vom Boden 11 der Führungsschiene 8 frei geschnitten. Diese Trennung zwischen Boden 11 und Ausbuchtung 10 bewirkt eine schlitzzartige Öffnung 13. Vor allem wird durch die Trennung der Ausbuchtung 10 vom Boden 11 vermieden, dass durch die Ausbiegung der Seitenwand 12 im Bereich der Ausbuchtung 10 auch der Boden 11 verformt wird.

Die freigeschnittenen Ausbuchtungen 10 sind in Figur 6 in der Draufsicht gezeigt. Deutlich zu erkennen sind die Öffnungen 13 zwischen dem Boden 11 und den Ausbuchtungen 10.

Die Führungsschiene 8 gemäß Figur 7 weist mehrere, paarweise angeordnete Einbuchtungen 14 auf. Die Einbuchtungen 14 sind zueinander nach innen gerichtet. Im Bereich der Einbuchtungen 14 ist die Seitenwand 12 vom Boden 11 der Führungsschiene 8 frei geschnitten. Dadurch wird zum einen vermieden, dass der Boden 11 der Führungsschiene 8 durch die Einformung der Einbuchtung 14 verbogen wird. Zum anderen gewährleistet die Trennung der Seitenwand 12 vom Boden 11 im Bereich der Einbuchtung 14, dass die Einbuchtungen 14 eine gewisse Elastizität aufweisen, so dass sie federnd nachgeben. So kann ein gewünschter Anpressdruck der Einbuchtungen 14 an die Leiterplatte erreicht werden.

Wird eine Leiterplatte einer Steckbaugruppe in der Führungsschiene 8 mit nach innen weisenden Einbuchtungen 14 geführt, so berühren die Oberflächen der Leiterplatte die Führungsschiene 8 nur im Bereich der Einbuchtungen 14. Die Leiterplatte wird also lediglich von den Einbuchtungen 14 in ihrer Position gehalten.

Verfügt eine Leiterplatte über Kontaktflächen an ihrem unteren Rand, wobei die Kontaktflächen in einzelne Segmente unterteilt und mit Logikteilen und/oder Masseflächen auf der Leiterplatte selbst verbunden sind, so findet beim Einschieben der Leiterplatte in die Führungsschiene 8 an den ersten Einbuchtungen 14 eine elektrostatische Entladung der Steckbaugruppe statt. Die Einbuchtungen 14 der Führungsschiene 8 sind dabei so anzuordnen, dass sie bei vollständig in die Führungsschiene eingeschobener Steckbaugruppe an den isolierenden Flächen

- 11 -

am unteren Rand der Leiterplatte der Steckbaugruppe anliegen.

Figur 8 zeigt die Führungsschiene 8 mit den nach innen weisenden Einbuchtungen 14 nochmals in der Draufsicht. Deutlich zu erkennen ist, dass der Abstand  $b$  zwischen den Einbuchtungen 14 geringer ist als der zwischen den Seitenwänden 12. Hier entspricht der Abstand  $b$  zwischen den Einbuchtungen 14 der Dicke der Leiterplatte der Steckbaugruppe. Dadurch wird gewährleistet, dass die Leiterplatte durch die Einbuchtungen 14 gehalten wird und die Oberfläche der Leiterplatte nur im Bereich der Einbuchtungen 14 Kontakt zur Führungsschiene 8 hat.

- 12 -

S 5703/03-EU

17. Januar 2003

**Zusammenstellung der Bezugszeichen**

- 1 Seitenteil
- 2 Kopfteil
- 3 Bodenteil
- 4 Rahmen
- 5 Randflächen
- 6 vordere Rahmenleiste
- 7 hintere Rahmenleiste
- 8 Führungsschiene
- 9 Aufweitung
- 10 Ausbuchtung
- 11 Boden
- 12 Seitenwand
- 13 Öffnung
- 14 Einbuchtung

- 13 -

S 5703/03-EU

17. Januar 2003

### Patentansprüche

1. Kopf- oder Bodenteil für einen Baugruppenträger, mit einem umlaufenden Rahmen und mit zwischen der vorderen und hinteren Rahmenleiste angeordneten und in Einschubrichtung ausgerichteten Führungsschienen (8) zur Aufnahme einer Leiterplatte einer Steckbaugruppe, wobei die Führungsschienen (8) im Querschnitt U-förmig ausgebildet sind und einen Boden (11) und zwei Seitenwände (12) umfassen, dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenwände (12) der Führungsschienen (8) mindestens eine seitliche Ausbuchtung (10) aufweisen.
2. Kopf- oder Bodenteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass beide Seitenwände (12) der Führungsschiene (8) mindestens eine Ausbuchtung (10) aufweisen.
3. Kopf- oder Bodenteil nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Ausbuchtungen (10) paarweise gegenüber liegen.
4. Kopf- oder Bodenteil nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand zwischen den Seitenwänden (12) der Führungsschiene (8) der Dicke der Leiterplatte entspricht.
5. Kopf- oder Bodenteil nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausbuchtungen (10) der Seitenwände (12) mit Kontaktflächen am unteren Rand der Leiterplatte korrespondieren.
6. Kopf- oder Bodenteil für einen Baugruppenträger, mit einem umlaufenden Rahmen und mit zwischen der vorderen und hinteren Rahmenleiste angeordneten und in Einschubrichtung ausgerichteten Führungsschienen (8) zur Aufnahme einer Leiterplatte einer Steckbaugruppe, wobei die Führungsschienen (8) im

...

- 14 -

Querschnitt U-förmig ausgebildet sind und einen Boden (11) und zwei Seitenwände (12) umfassen, dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenwände (12) der Führungsschienen (8) mindestens eine seitliche Einbuchtung (14) aufweisen.

7. Kopf- oder Bodenteil nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass beide Seitenwände (12) der Führungsschiene (8) mindestens eine Einbuchtung (14) aufweisen.

8. Kopf- oder Bodenteil nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Einbuchtungen (14) paarweise gegenüber liegen.

9. Kopf- oder Bodenteil nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand zwischen zwei gegenüberliegenden Einbuchtungen (14) der Dicke der Leiterplatte entspricht.

10. Kopf- oder Bodenteil nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Einbuchtungen (14) mit isolierenden Bereichen und/oder Masseflächen am unteren Rand der Leiterplatte korrespondieren.

11. Kopf- oder Bodenteil nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich der Ausbuchtungen (10) und/oder der Einbuchtungen (14) die Seitenwände (12) vom Boden (11) der Führungsschiene (8) getrennt ist, so dass eine schlitzartige Öffnung (13) entsteht.

12. Kopf- oder Bodenteil nach einem der Ansprüche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Einbuchtungen (14) federnd ausgebildet sind.

13. Kopf- oder Bodenteil nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Übergang zwischen den Seitenwänden (12) und den Ausbuchtungen (10) oder den Einbuchtungen (14) schräg oder abgerundet ausgebildet ist.

...

S5703/03-EU

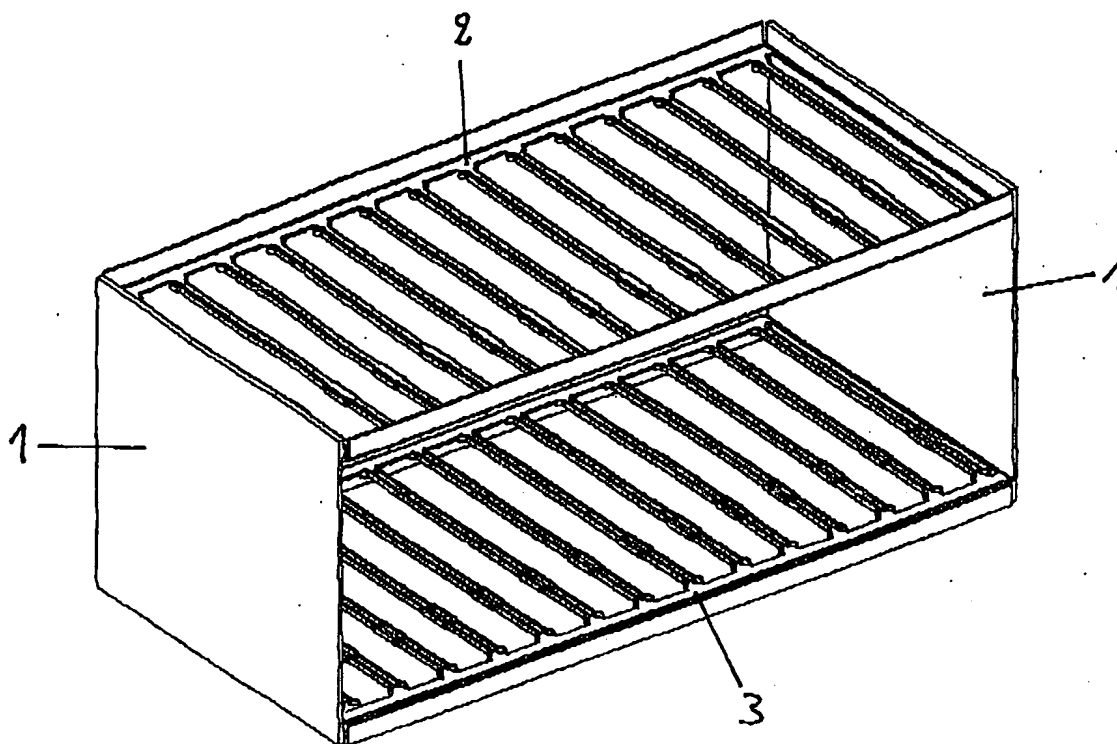


Fig. 1

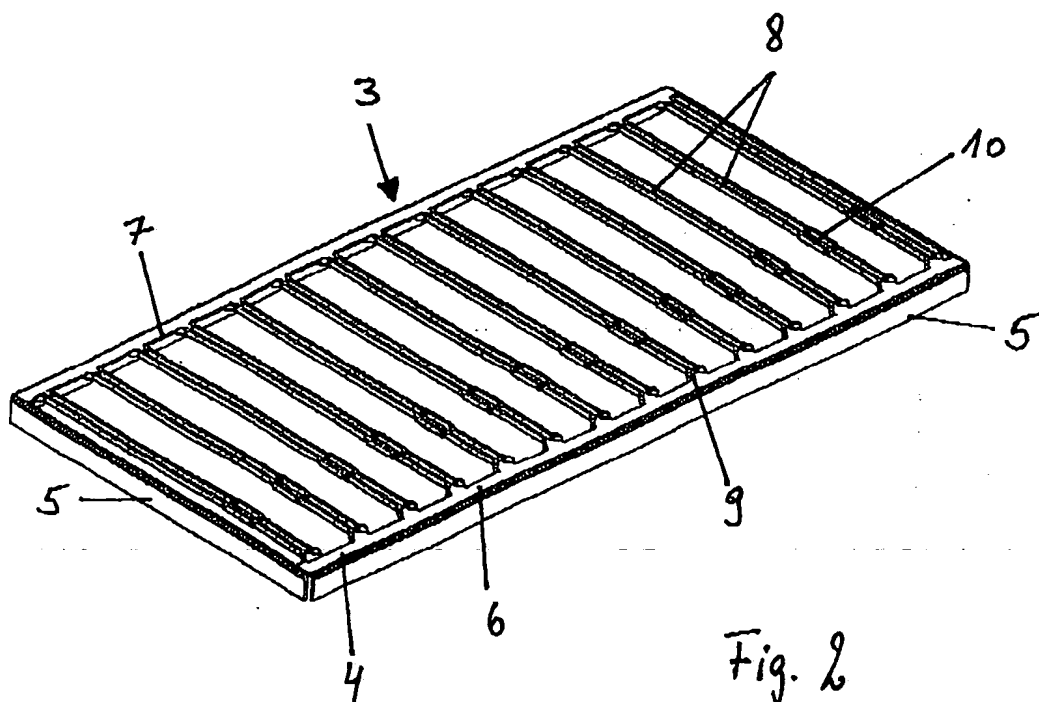


Fig. 2

S 5703/03-EU

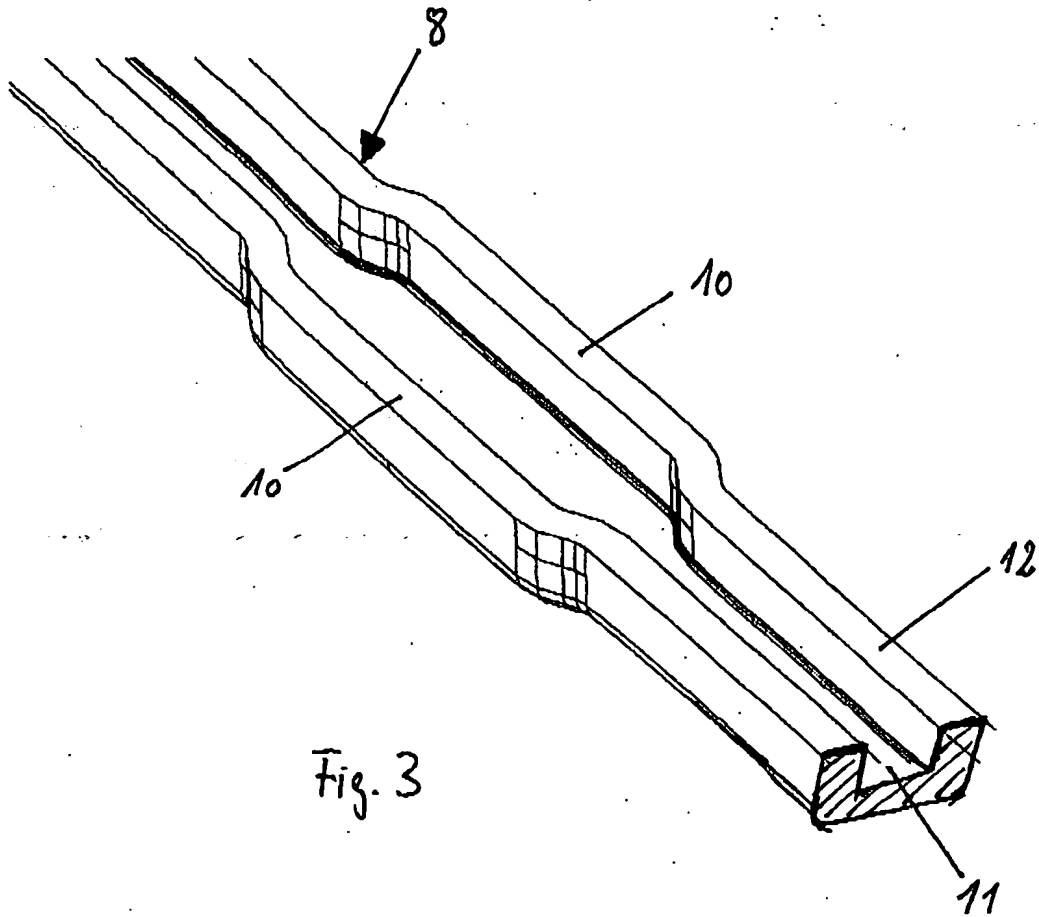


Fig. 3

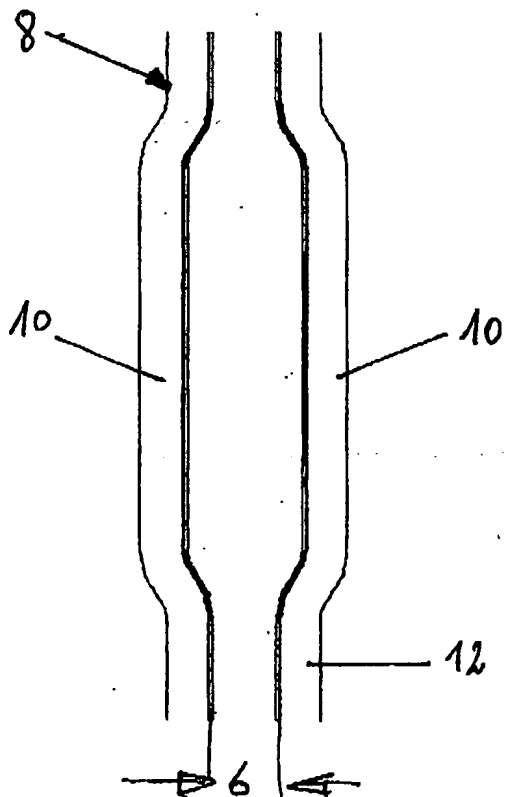
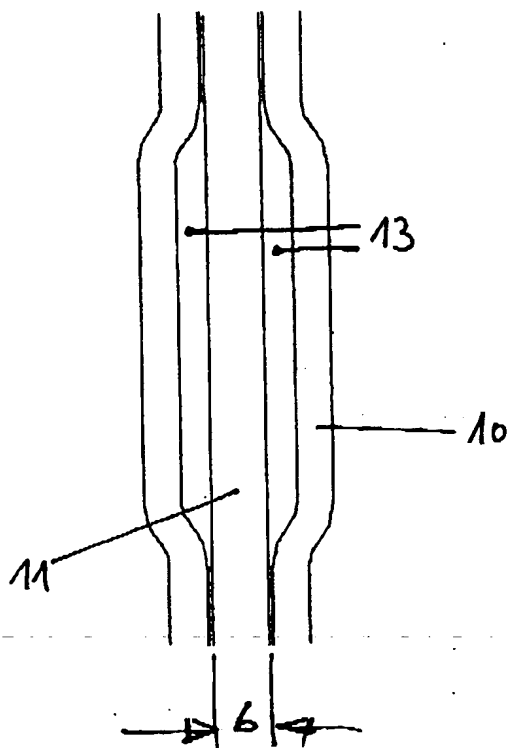
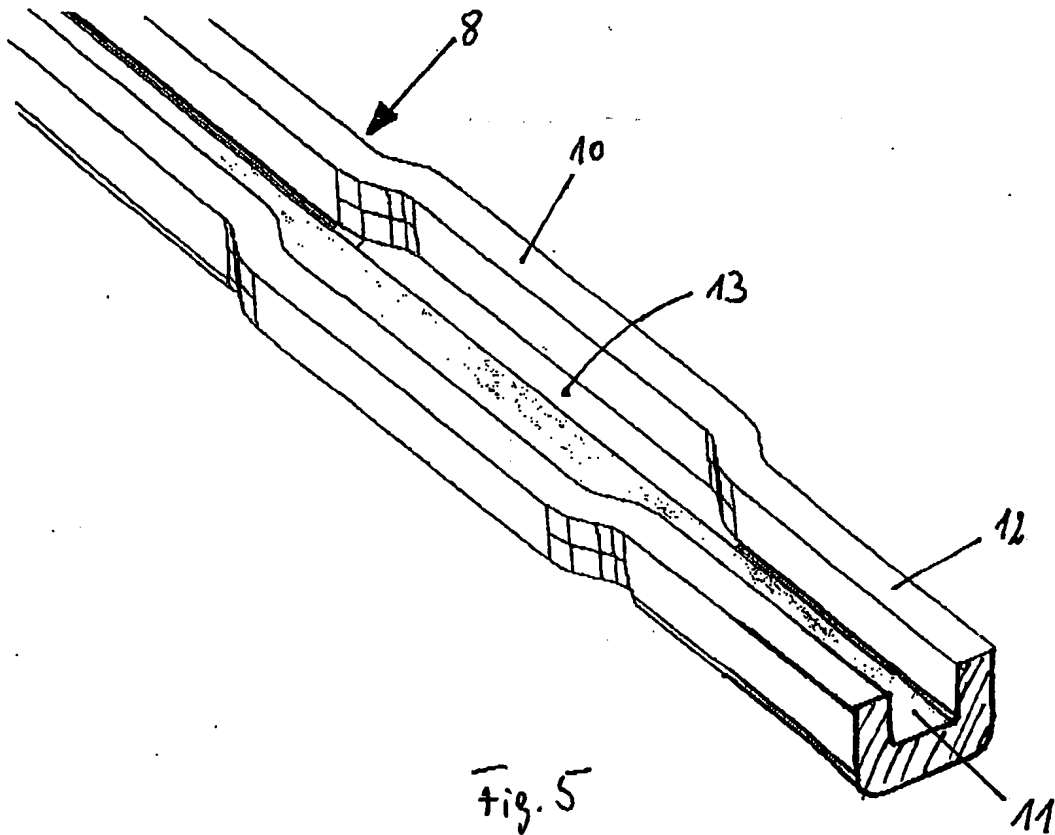


Fig. 4





S 5703/03 - EU

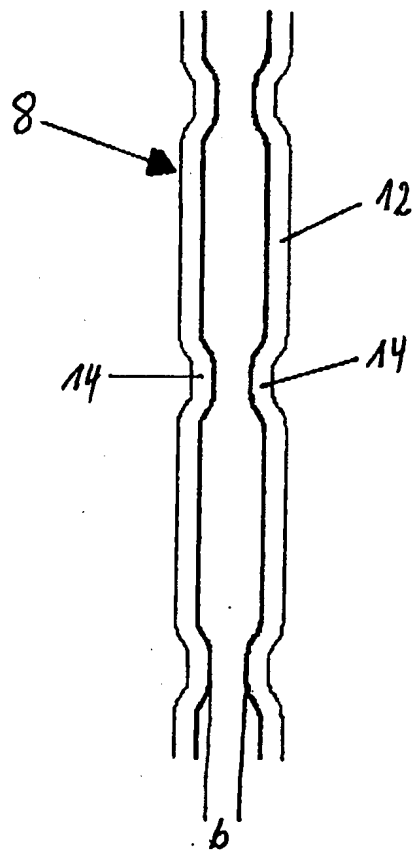
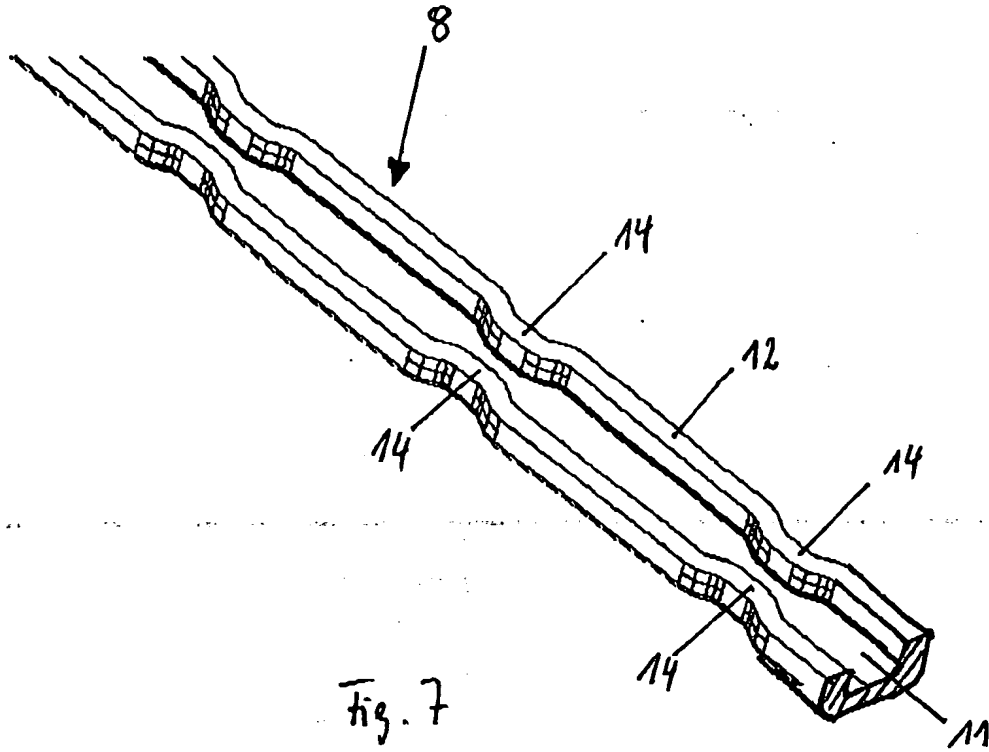
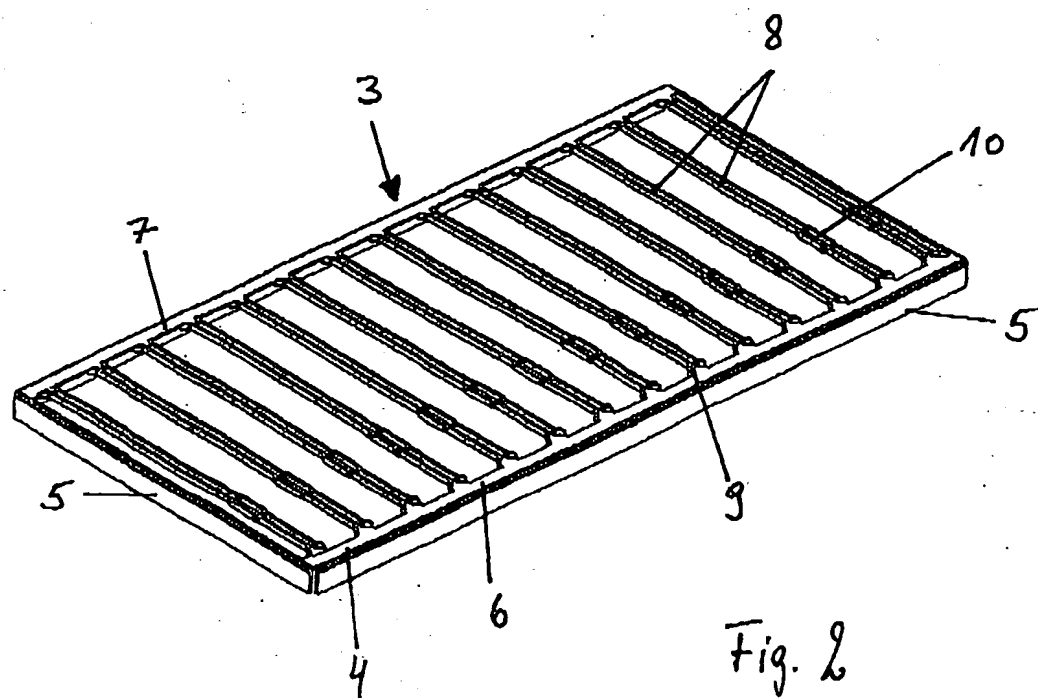


Fig. 8



S 5703/03-EU

17. Januar 2003

### Zusammenfassung

Ein Kopf- oder Bodenteil für einen Baugruppenträger hat einen umlaufenden Rahmen und mit zwischen der vorderen und hinteren Rahmenleiste angeordnete und in Einschubrichtung ausgerichtete Führungsschienen (8) zur Aufnahme einer Leiterplatte einer Steckbaugruppe. Die Führungsschienen (8) sind im Querschnitt U-förmig ausgebildet und umfassen einen Boden (11) und zwei Seitenwände (12). Die Seitenwände (12) der Führungsschienen (8) weisen mindestens eine seitliche Ausbuchtung (10) auf. Die Ausbuchtungen (10) können an beiden Seitenwänden (12) der Führungsschiene (8) vorgesehen sein und sich paarweise gegenüberliegen. Es können auch nach innen weisende Einbuchtungen vorgesehen sein.

(Figur 2)